

厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第二期)票面利率公告

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券已于 2025 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕623 号）。根据《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告》，发行规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

2025 年 7 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（债券简称：25 圆融 K3，债券代码：524348），利率询价区间为 1.45%-2.45%；本期债券品种二（债券简称：25 圆融 K4，债券代码：524349），利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.83%，本期债券品种二票面利率为 2.14%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 7 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：厦门金圆投资集团有限公司

2025 年 7 月 9 日



(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司
（公章）

2025 年 7 月 9 日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华福证券有限责任公司
（公章）



2025 年 7 月 9 日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：金圆统一证券有限公司



2025年7月9日

(本页无正文,为《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2025 年7 月9 日